

현재, 세계적인 에너지 문제를 배경으로, 태양전지용 패널의 수요 확대에 수반하여 이에 사용되는 원통형 타겟의 수요도 급격히 증가하고 있습니다.

주식회사 테크노화인에서는, 2003 년부터, 원통형 타겟의 본딩 가공을 시작하여, 수많은 경험에 의해 완성된 기술로, 이 시장의 요구에 응할 수 있도록, 양산화 체제를 확립함과 더불어, 원통형 타겟용 초음파 측정 장치를 개발함으로써, 안정된 품질과 높은 생산 효율에 의한, 본딩 가공 서비스를 행하고 있습니다.

원통형 타겟으로는, 이하의 4 개의 커다란 특성이 기대됩니다.

- 1, 고스퍼터 효율
- 2, 낮은 아킹
- 3, 마디, 흑 등이 없음.
- 4, 고효율

이를 통해 모든 제품에 있어서 높은 품질과 신뢰성 높은 본딩 가공을 실현하였으며 그 장점을 유감없이 발휘할 수 있습니다.

주식회사 테크노화인의 원통형 본딩 기술은, 하기의 특징을 가지고 있습니다.

- 1, 모든 사이즈에 대응 할 수 있는 프로세스(최대 3 M 까지 대응 가능)
- 2, 높은 치수 정밀도 (분할 타입 타겟에서도 높은 치수 정밀도 확보 가능)
- 3, 안정된 품질 (초음파 장치에 의한 전수 검사를 실시)

주식회사 테크노화인에서는 일본에서 이 기술을 제공함과 함께 2009 년도 원래의 계획대로 순차적으로 해외에 공장에 이 기술을 전개해 전 세계에 제공 할 수 있도록 하고 있습니다.